

NIR-MX 系列

工业检测需要利用红外光的穿透性来对芯片内部进行更加清晰准确的非破坏检测和分析，这在光通讯领域、先进封装、晶圆制造中是必需的检测技术。由舜宇自主研发的 NIR-MX 系列工业红外显微成像系统是国内领先的近红外检测设备，使用的红外波长更长，穿透硅片的能力更强，成像更加清晰，是工业检测领域强有力的解决方案。



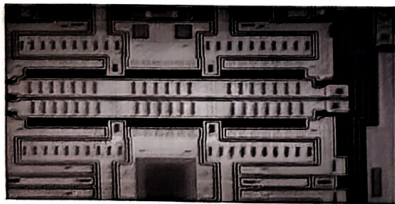
NIR-MX12R



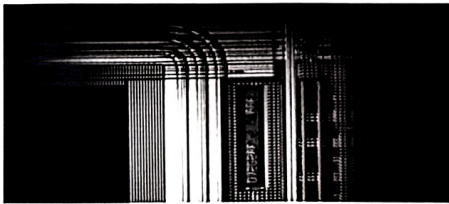
NIR-MX68R

NIR-MX 系列 技术规格

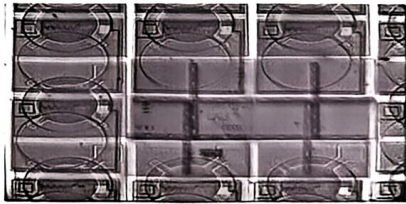
型号	NIR-MX68R 工业红外显微系统		NIR-MX12R 工业红外显微系统
光学系统	无限远色差校正光学系统		
观察方式	明场 / 红外		
观察筒	红外三目观察头，30 度倾斜，正像，瞳距调节范围 50-76mm，两档式分光比，双目：三目 =100：0 或 0：100		
目镜	高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm，视度可调，可带测微尺		
	高眼点大视野平场目镜 PL10X/23mm，视度可调，可带测微尺		
物镜	平场半复消红外物镜（5X、10X、20X、50X）		
转换器	六孔电动转换器（带 DIC 插槽）		
镜体	反射式 / 透反射机架：前置低手位粗微同轴调焦机构。升降行程 35mm，精度 1μm。带有防止下滑的松紧调节装置和机械上限位装置，内置 100-240V 宽电压系统		
载物台	8 英寸三层机械移动平台，低手位 X、Y 方向同轴调节；平台面积 525mmX330mm，移动范围 210mmX210mm；带离合器手柄，全行程范围内快速移动；玻璃载物台板（反射用）；旋转工作台 / 8 寸晶圆盘，适用于 6、8 寸晶圆	12X14 英寸三层机械移动平台，低手位 X、Y 方向同轴调节；平台面积 420mmX710mm，移动范围 305mmx356mm，带离合器手柄，可用于全行程范围内快速移动；金属载物台板（反射用），玻璃载物台板（透 / 反射用），旋转工作台 / 12 寸晶圆盘，适用于 6、8、12 英寸晶圆	
	6 英寸三层机械移动平台，低手位 X、Y 方向同轴调节；平台行程范围内快速移动；玻璃载物台板（反射用），旋转工作面积 445mmX240mm，反射照明移动范围 158mm×158mm，透射照明移动范围 100×100mm；带离合器手柄，可用于全台 / 6 寸晶圆盘，适用于 4、5、6 英寸晶圆		
照明系统	红外反射照明器，带明场、红外切换装置；带可变电动孔径光阑，中心可调；带滤色片插槽；12V100W 卤素灯室（透 / 反用），预定中心		
滤色片	带通滤色片（1100nm、1200nm、1300nm）		
相机	130 万像素红外相机（400-1700nm），灰度相机，帧率 72fps@1280×1024，像元尺寸 5μm		
	320 万像素红外相机（400-1100nm），单色相机，帧率 120fps@2064×1544，像元尺寸 3.45μm		
摄影摄像	1X 摄像接筒，C 型接口，可调焦		
其他	高精度测微尺、PC，软件带图像处理、图像采集、图像管理、测量功能		



CSP/SIP 的非破坏检查



封装的不佳状况无损分析



MEMS 器件近红外检测